

- フィラーコンポジットの粘度予測
- ハイブリッド化によるフィラー量低減と熱伝導性向上の両立
- 熱伝導性向上のためのフィラーの表面処理



# 【名古屋開催】 フィラー活用による 熱伝導性材料&放熱材料の設計・開発技術 フィラーコンポジットの熱伝導率を向上するフィラーの使いこなし技術



日時	2019年10月9日(水) 13:00~16:30	会場	愛知・名古屋市中村区 愛知県産業労働センター ウィンクあいち 12F 1209
受講料	44,000円 ⇒ S&T会員 41,800円 ※S&T会員(郵送DM案内あるいはE-mail案内を希望される方)は価格が5%OFFになります。 (定価: 本体40,000円+税4,000円 会員: 本体38,000円+税3,800円)		資料付

**講師** 富山県立大学 工学部 機械システム工学科 教授 博士(工学) 真田 和昭 氏  
**紹介** [元(株)日立製作所]

**趣旨** 近年、コンポジット材料の熱伝導率を格段に向上させる微視構造設計手法として、フィラーの最密充填技術、フィラーのハイブリッド化による伝熱ネットワーク構造形成技術が注目されており、現在、窒化物フィラーは有効な高熱伝導性フィラーとして期待されている。  
 本セミナーでは、窒化物フィラーを中心として、フィラーの充填・表面改質技術とフィラーを用いたコンポジット材料の熱伝導率向上のための微視構造設計・特性評価技術について概説し、フィラーの使いこなし技術を習得することを目指す。

<b>プログラム</b>	1. フィラーの種類と熱伝導率 1.1 フィラーの種類と熱伝導率 1.2 フィラーの形状 1.3 フィラーの粒度分布	4. フィラーのハイブリッド化によるフィラー量低減と熱伝導性向上の両立 4.1 ナノフィラー活用によるネットワーク構造形成事例 4.2 ナノ・マイクロハイブリッドフィラーを用いた複合材料の熱伝導率向上事例
	2. フィラーコンポジットの粘度予測 2.1 コンポジットの粘度予測式と適用範囲 2.2 フィラー粒度分布を考慮したコンポジットの粘度予測理論	
	3. フィラーの高充填技術 3.1 フィラー最密充填理論 3.2 フィラー最密充填によるコンポジットの高熱伝導率と低粘度の両立 3.3 数値シミュレーションを活用した新しいフィラー充填構造設計手法	6. フィラーコンポジット材料の熱伝導特性評価 6.1 コンポジットの熱伝導率予測式 6.2 微視構造モデルを用いた熱伝導率予測シミュレーション
		7. 国内外での窒化物フィラーコンポジットの開発動向

□ 質疑応答 □

■ 2名同時申込みで1名分無料 ■  
(1名あたり定価半額の22,000円)

※2名様ともS&T会員登録をいただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。  
 ※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。  
 ※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。  
 ※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。  
 ※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。 ※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

**セミナー申込用紙** F191009 (【名古屋】熱伝導性材料)

会社名 団体名			
部署			
役職	〒		
ふりがな	住所		
氏名			
TEL	FAX		
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。		

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。  
 ※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

<b>今後のご案内</b>	
<input type="checkbox"/> E-mail希望・登録済み	S&T会員価格を 適用いたします。 (E-mailアドレス必須)
<input type="checkbox"/> 郵送希望・登録済み	
<input type="checkbox"/> 希望しない	
<b>お支払方法</b>	
<input type="checkbox"/> 銀行振込 (振込予定日 月 日)	
<input type="checkbox"/> 当日現金払い	
<b>通信欄</b>	

● 受講料について  
「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。  
 ● お申込みについて  
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。  
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。  
お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。  
 ● お支払いについて  
受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。  
銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。  
振込手数料はお客様がご負担ください。

● 個人情報の取り扱いについて  
ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。  
詳しくはホームページをご覧ください。  
 ● キャンセル規定  
開催日から逆算(営業日: 土日・祝祭日等を除く)いたしまして、  
・開催7日前以前のキャンセル: キャンセル料はいただきません。  
・開催3~6日前でのキャンセル: 受講料の70%  
・開催当日~2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%  
※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。

**S&T サイエンス & テクノロジー**  
 研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍  
 サイエンス&テクノロジー株式会社  
 TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187  
 〒105-0013  
 東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F  
<http://www.science-t.com>